

公司代码：688519

证券简称：南亚新材



**南亚新材料科技股份有限公司**

(注册地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号)

**2025年度向特定对象发行A股股票  
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二五年十二月

在国家产业政策、发展规划以及公司发展战略的指引下，针对宏观环境、行业环境和公司现状的变化，为顺利推进公司业务发展，提高公司盈利能力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南亚新材 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。）

## 一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 90,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	基于 AI 算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目	74,530.78	74,000.00
2	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		90,530.78	90,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## 二、本次募集资金投资项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、基于 AI 算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目

建设基于 AI 算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目预计总投资 74,530.78 万元，拟使用募集资金投资 74,000.00 万元，规划建设期 24 个月，第三年开始试生产，至第五年达产。本项目的实施主体为公司全资子公司南亚新材料科技（江苏）有限公司，地点位于江苏省南通市，拟建设年产能 720 万张高阶高频高速覆铜板和 1,600 万米粘结片。

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

截至本可行性分析报告公告日，本次募投项目的备案手续、环评手续尚在办理中，公司将根据相关要求履行审批程序。

## 2、补充流动资金

公司本次募集资金拟使用 16,000.00 万元用于补充流动资金，以满足未来业务增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。

### （二）项目实施的必要性

#### 1、顺应行业发展趋势，符合国家和公司的发展战略

在国家大力发展战略性新兴产业的背景下，随着 AI、6G 通信、云计算、大数据、智能网联汽车等新技术、新产业的蓬勃发展，我国覆铜板产业将迎来战略机遇期。面对这一战略机遇期，公司顺应行业发展趋势，以“抓住覆铜板行业发展机遇，实施稳健扩张”为总体战略，以技术驱动、成本优化、管理增效为抓手，始终聚焦于覆铜板行业，强化以高速覆铜板为代表的高端产品技术优势。

同时，近两年公司的产品应用领域结构持续升级，AI 服务器、交换机和光模块等领域高附加值产品对公司的技术能力、质量稳定性和交付能力的要求不断提高。在此背景下，本项目通过建设高端覆铜板智能工厂，推进先进生产设备及相关配套设施的建设及投入，进一步提升生产工艺和技术水平，扩展高速等高端覆铜板的产品体系和产能。本项目的建设将更好地支撑行业对高阶高频高速等高端电子基材的产业化需求，有利于推动电子材料技术的发展，对于落实国家发展战略规划具有重要意义。

#### 2、扩展高阶高频高速等高端覆铜板的产品体系和产能，提升国产材料竞争

## 力

根据 Prismark 统计数据，全球高频高速及 IC 封装材料等特殊覆铜板市场规模从 2020 年的 39.30 亿美元增至 2024 年的 56.65 亿美元。2024 年，特殊覆铜板市场前十五大企业的营业收入占全球企业营业收入比例为 96.40%，呈高度集中的态势，其中全球前五大企业主要为中国台湾、日本和韩国的企业，合计市场份额为 62.60%。前十五大企业中中国大陆企业有生益科技、南亚新材和华正新材，市场份额合计仅为 8.30%。尽管全球特殊覆铜板市场中外资企业仍占据主导地位，但以生益科技、南亚新材和华正新材等为代表的中国大陆企业经过多年发展，行业地位逐步提升。近年来，公司在 ML、LL、VLL、ULL、ELL 等各介电损耗等级高速产品通过独立自主的方式形成产品并已通过优质客户认证，公司通过本项目建设扩展高阶高频高速等高端覆铜板的产品体系。

此外，高速覆铜板对上胶机的精度和均匀性控制要求极高，以确保关键树脂材料的涂布一致性，从而控制介电常数 (Dk) 和介电损耗因子 (Df) 的稳定性，对压机的温控系统精确性有更高的要求，确保在数百度高温下 Dk 值稳定，同时对生产环境的洁净度有严苛要求，防止杂质引入导致信号损耗增加，公司现有的产线在功能、效率等方面并不能很好地支撑高速覆铜板材料的进一步量产，亟需新建洁净度更高、智能化程度更高的产线。公司现有产能难以满足市场与客户迅速增长的需求，产能瓶颈已成为阻碍公司业务规模增长和制约公司盈利能力提升的重要因素。公司需要建设新的高阶高频高速覆铜板生产基地、扩充高阶高频高速覆铜板产能。

综上，公司通过本项目建设扩展高速等高端覆铜板的产品体系和产能，进一步提升国产材料竞争力。

### 3、扩大市场占有率，巩固并提升公司的行业地位

在人工智能技术与各类应用呈井喷式发展的当下，与 AI 紧密关联的服务器、数据存储设备等需求快速增加。根据 Prismark 预测，全球电子系统市场将由 2024 年的 25,540 亿美元增长至 2029 年的 33,880 亿美元，年均复合增长率约为 5.8%；其中服务器及数据存储领域预计将从 2024 年的 2,910 亿美元增至 2029 年的 5,510 亿美元，年均复合增长率达 13.6%，显著高于行业整体年均复合增长率。

基于服务器、数据存储等算力基础设施市场的快速增长，公司通过本次项目建设，有助于扩大市场占有率，进一步推动公司业务规模的持续增长，进而提升公司在高端材料的市场份额和盈利能力。

#### **4、满足公司业务快速发展的资金需求，改善资产负债结构**

通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，公司将提升资本实力，优化资本结构，扩大业务规模，增强抗风险能力和持续经营能力。2024 年以来，公司的营业收入和利润规模快速增长，未来几年公司仍将大力投入，抢先布局 AI 算力等领域，筑牢技术优势，抢抓发展机遇。截至 2025 年 9 月 30 日，公司未经审计合并报表资产负债率为 51.73%，通过本次补充流动资金，公司资本结构将得到进一步优化，资产负债率、财务成本和偿债风险亦将得到有效降低。本次募投项目的实施将进一步增强公司的可持续发展能力，为公司的高效运营和后续发展提供有力的财务支持。

### **(三) 项目实施的可行性**

#### **1、国家产业政策为项目实施提供政策保障**

近年来，国家出台一系列产业政策，如《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》《电子信息制造业数字化转型实施方案》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等，相关政策有力推动了我国电子信息行业的快速发展，为项目实施提供政策保障。

#### **2、公司较强的技术实力为项目实施提供技术保障**

公司一直专注于覆铜板、粘结片等高端电子电路基材的技术研发，是国家级高新技术企业、上海市专利工作示范企业及上海市专精特新企业，拥有上海市市级企业技术中心及博士后创新实践基地。近年来，公司陆续实现超薄化、高频高速等技术的重大突破，1 项产品被列入国家重点新产品计划，2 项产品被列入国家火炬计划，11 项产品获上海市高新技术成果转化项目，4 项产品获上海市推荐创新产品，3 项产品获上海市专利新产品，另有多项技术获上海科学技术奖或中

华全国工商业联合会的科技进步奖。截至 2025 年 9 月末，公司累计获得境内专利 111 项，其中发明专利 47 项，实用新型 64 项，境外专利 4 项，主导或参与制定国家标准 7 项、行业标准 4 项、团体标准 3 项。

公司自成立以来，始终坚持自主研发，产品广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域，目前已形成无铅、无卤、高频高速、车载、高导热、IC 封装、HDI 等一系列核心配方技术，多项核心技术处于国内领先或国际先进水平，公司还构建了省级企业技术中心，CNAS 实验室等研发平台为技术研发提供有利保障。

### **3、公司优质的客户资源为新增产能消化提供有力保障**

公司作为覆铜板行业领域的头部企业，凭借深厚的技术储备和丰富的产品类型拓展市场并获得客户认可，积累了稳定的客户资源，为项目实施提供了有力的支撑。本项目公司通过前期工作的开展，全系列各介电损耗等级高速材料已率先通过国内重要通讯设备龙头厂商认证，并实现量产。公司产品获得了深南电路、方正科技、沪电股份、胜宏科技、生益电子、景旺电子、奥士康等 PCB 客户以及终端重点客户的认证。后续公司将进一步巩固深化与现有客户合作，积极开拓新客户，为产能消化提供保障，并将持续加强营销团队建设，打造专业的培训体系、健全人员激励机制，提高公司营销人员的专业技术水平，强化公司营销人员的服务意识，提高公司营销人员的市场推广和开拓能力，从而增强与客户的紧密度及粘性。

### **4、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制**

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

### 三、本次募集资金投资属于科技创新领域

#### （一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司自 2000 年成立以来，始终专注于覆铜板和粘结片等电子电路基材的研发、生产与销售业务。覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体。覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件，被广泛应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。

公司所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条规定的“（三）新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关服务等”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司的覆铜板及粘结片产品属于“新材料产业”中的“高性能热固性树脂基复合材料”，公司下游 PCB 及其终端应用产品则涵盖了“新一代信息技术产业”等领域。根据国务院第五次全国经济普查领导小组办公室发布的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司的覆铜板及粘结片产品属于“新材料产业”中的“高性能热固性树脂基复合材料”和“高频微波、高密度封装覆铜板”，公司下游 PCB 及其终端应用产品则涵盖了“新一代信息技术产业”等领域。本次募投项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金投向符合国家产业政策，主要投向科技创新领域的主营业务。

本次向特定对象发行股票募集资金拟用于“基于 AI 算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目”和“补充流动资金”，通过本次募投项目的实施，公司的产能将得到进一步的优化和升级，有利于进一步拓展 AI 服务器、数据存储等高附加值领域，提升技术水平与研发成果转化进度，持续强化公司的科创实力。

因此，本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。

公司本次募集资金投向不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务。

#### （二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

公司本次募投项目的实施，有助于公司的技术水平、生产工艺水平紧跟行业技术发展趋势；有助于公司产品研发产业化和产品迭代升级，扩展公司高阶高频高速产品体系及产能，可以更好地满足终端客户快速增长的差异化、高端化需求。公司将加速推进产品和业务的创新，促进公司科技创新水平的持续提升，进一步增强公司核心竞争力。

## 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

### （一）对公司经营管理的影响

公司本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家和公司的发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于进一步巩固公司竞争优势，提升公司综合实力，为公司未来战略布局奠定坚实基础。

### （二）对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司的资本实力将进一步增强，总资产和净资产规模均会有所提升，资产负债率下降，财务风险将有效降低。这将有利于增强公司的偿债能力，优化资本结构，促进公司健康发展。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，进而为公司和股东带来更好的投资回报。

## 五、总结

综上，本次募集资金投资项目符合法律法规的规定及公司经营发展战略。本次募集资金投资项目的实施有利于公司的可持续发展及盈利能力的提升，符合公司及全体股东利益。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日